

超配（维持）

半导体行业双周报（2024/09/02-2024/09/15）

苹果、华为先后发布新品

2024年09月15日

刘梦麟

SAC 执业证书编号：

S0340521070002

电话：0769-22110619

邮箱：

liumenglin@dgzq.com.cn

陈伟光

SAC 执业证书编号：

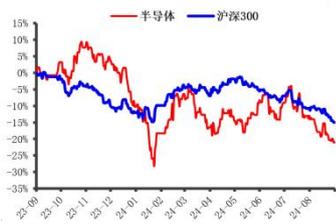
S0340520060001

电话：0769-22119430

邮箱：

chenweiguang@dgzq.com.cn

半导体行业（申万）指数走势



资料来源：东莞证券研究所，iFind

相关报告

投资要点：

- **半导体行业指数近两周涨跌幅：**截至2024年9月13日，半导体行业指数近两周（2024/9/2-2024/9/13）累计下跌7.91%，跑输沪深300指数3.03个百分点；9月以来累计下跌7.91%，跑输沪深300指数3.03个百分点；2024年以来累计下跌23.21%，跑输沪深300指数15.29个百分点。
- **半导体行业指数子板块近两周涨跌幅：**截至2024年9月13日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW半导体材料（-5.67%）>SW分立器件（-5.75%）>SW模拟芯片设计（-5.85%）>SW半导体设备（-6.11%）>SW数字芯片设计（-6.69%）>SW集成电路封测（-8.43%）。
- **近两周部分新闻和公司动态：**（1）Canalys：上调2024年全球智能手机出货量预测至12亿台；（2）集邦咨询：预计2024年第三季度全球智能手机产量环比小幅回升，同比下降约5%；（3）全球折叠屏智能手机出货量2024年第二季度同比增长48%，中国出货量超过一半；（4）TechInsights：2025年全球智能手机出货量将同比增长2.9%；（5）机构：7月全球半导体销售额达513亿美元，同比增长18.7%；（6）联发科8月销售额415.3亿元台币，同比下降1.72%；（7）日月光8月营收呈双增长 创九个月新高；（8）联发科8月销售额415.3亿元台币，同比下降1.72%；（9）华为发布全球首款三折叠屏手机，售价19999元起；（10）Canalys：到2028年全球54%的智能手机出货为AI手机；（11）英伟达CEO：Blackwell需求太旺，供不应求让客户关系变得紧张；（12）龙芯中科：首款独立显卡芯片9A1000研制工作全面展开。
- **周报观点：**进入2024年，伴随着下游需求回暖以及厂商推进库存去化，半导体行业迈入上行周期，从半年报业绩看，半导体行业2024年上半年经营业绩实现同比增长，设备、材料、存储、CIS、封测等细分板块龙头企业Q2业绩大多表现出色，且苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期，表明行业景气度延续，而苹果、华为等消费电子大厂先后发布新机，科技板块关注度有望提升。展望Q4，随着消费电子旺季的到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进，半导体行业景气度有望维持较好水平。可关注Q2业绩表现出色的设备、存储、CIS、封测等细分板块。
- **风险提示：**终端需求不及预期、国产替代不及预期、价格竞争加剧等。

本报告的风险等级为中高风险。

本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。

请务必阅读末页声明。

目录

1. 半导体行业行情回顾	3
2. 半导体产业新闻	4
3. 公司公告与动态	6
4. 半导体产业数据更新	6
4.1 智能手机出货数据	6
4.2 新能源汽车销售数据	7
4.3 全球、国内半导体月度销售数据	7
4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据	7
5. 投资建议	8
6. 风险提示	12

插图目录

图 1: 半导体行业 2021 年初至今行情走势 (截至 2024 年 9 月 13 日)	3
图 2: 全球智能手机季度出货量	6
图 3: 国内智能手机月度出货情况	6
图 4: 新能源汽车销量及同比增长率	7
图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率	7
图 6: 全球半导体月度销售情况	7
图 7: 中国半导体月度销售情况	7
图 8: 全球半导体设备销售额 (季度)	7
图 9: 中国大陆半导体设备销售额 (季度)	7

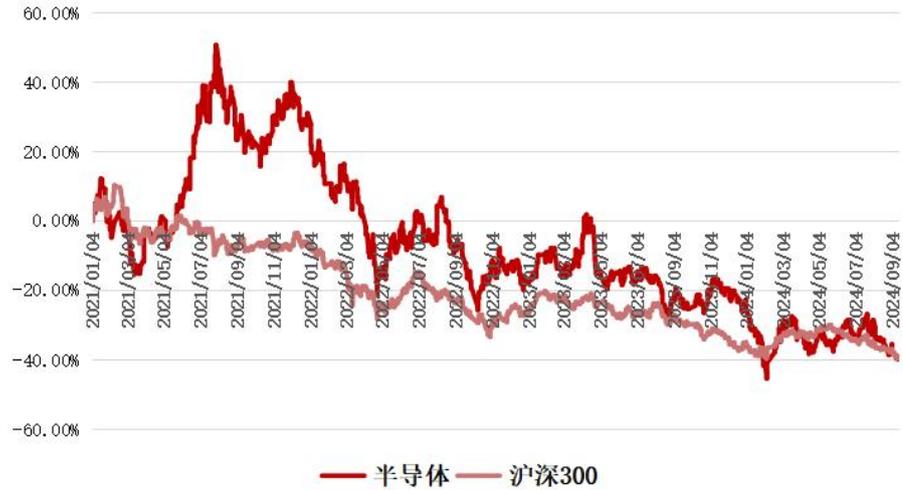
表格目录

表 1: 申万半导体行业各子板块涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 9 月 13 日)	3
表 2: 申万电子所有三级子行业涨跌幅情况 (单位: %) (截至 2024 年 9 月 13 日)	3
表 3: 建议关注标的介绍 (2024/9/13)	8

1. 半导体行业行情回顾

半导体行业指数近两周涨跌幅：截至 2024 年 9 月 13 日，半导体行业指数近两周（2024/9/2-2024/9/13）累计下跌 7.91%，跑输沪深 300 指数 3.03 个百分点；9 月以来累计下跌 7.91%，跑输沪深 300 指数 3.03 个百分点；2024 年以来累计下跌 23.21%，跑输沪深 300 指数 15.29 个百分点。

图 1：半导体行业 2021 年初至今行情走势（截至 2024 年 9 月 13 日）



资料来源：iFind，东莞证券研究所

截至 2024 年 9 月 13 日，申万半导体板块各细分指数近两周全面下跌，跌幅从低到高依次为：SW 半导体材料（-5.67%）>SW 分立器件（-5.75%）>SW 模拟芯片设计（-5.85%）>SW 半导体设备（-6.11%）>SW 数字芯片设计（-6.69%）>SW 集成电路封测（-8.43%）。

表 1：申万半导体行业各子板块涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 9 月 13 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850812.SL	分立器件	-5.75	-5.75	-33.61
2	850813.SL	半导体材料	-5.67	-5.67	-25.05
3	850814.SL	数字芯片设计	-6.69	-6.69	-18.49
4	850815.SL	模拟芯片设计	-5.85	-5.85	-38.51
5	850817.SL	集成电路封测	-8.43	-8.43	-17.90
6	850818.SL	半导体设备	-6.11	-6.11	-9.83

资料来源：iFind、东莞证券研究所

表 2：申万电子所有三级子行业涨跌幅情况（单位：%）（截至 2024 年 9 月 13 日）

序号	代码	名称	近两周涨跌幅	本月至今涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	850813.SL	半导体材料	-5.67	-5.67	-25.05
2	850818.SL	半导体设备	-6.11	-6.11	-9.83

3	850814.SL	数字芯片设计	-6.69	-6.69	-18.49
4	850815.SL	模拟芯片设计	-5.85	-5.85	-38.51
5	850817.SL	集成电路封测	-8.43	-8.43	-17.90
6	850812.SL	分立器件	-5.75	-5.75	-33.61
7	850853.SL	品牌消费电子	-1.38	-1.38	-26.34
8	850854.SL	消费电子零部件及组装	-9.06	-9.06	-10.75
9	850861.SL	电子化学品III	-4.70	-4.70	-28.99
10	850831.SL	面板	-4.45	-4.45	-19.69
11	850832.SL	LED	-5.61	-5.61	-30.29
12	850833.SL	光学元件	-5.05	-5.05	-21.58
13	850822.SL	印制电路板	-7.71	-7.71	0.27
14	850823.SL	被动元件	-5.79	-5.79	-11.89
15	850841.SL	其他电子III	-5.70	-5.70	-12.84

资料来源：iFind、东莞证券研究所

2. 半导体产业新闻

1. 【Canalys：上调 2024 年全球智能手机出货量预测至 12 亿台】

《科创板日报》4 日讯，Canalys 最新报告显示，2024 年第二季度，全球智能手机市场景气度持续提升，尽管增长好于预期，基于成本上涨，库存周转，营商环境带来的挑战，小幅上调 2024 年全球智能手机出货量预测至 12 亿台，同比上升 5%。长期来看，智能手机市场的年增长率将在今年的强势反弹后逐步进入平台期，2024 年至 2028 年将以 2% 的年复合增长率温和成长。

2. 【集邦咨询：预计 2024 年第三季度全球智能手机产量环比小幅回升 同比下降约 5%】

财联社 9 月 4 日电，根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，2024 年第二季由于部分品牌新机铺货期结束，加上季底进入库存调节等因素，全球智能手机生产总数落在 2.86 亿支，较第一季下降约 3%。由于旺季需求疲软，品牌厂在第三季的生产规划普遍趋于保守。因此，第三季生产总数预估仅有小幅季增，达 2.93 亿支，但仍较去年同期呈现约 5% 的下降。

3. 【全球折叠屏智能手机出货量 2024 年第二季度同比增长 48% 中国出货量超过一半】

财联社 9 月 5 日电，根据最新的 Counterpoint Research 折叠屏智能手机出货量追踪报告，全球折叠屏智能手机出货量在 2024 年第二季度同比增长了 48%。中国持续引领折叠屏手机市场的增长，占总出货量超过一半，而在本季度其他地区也看到了显著的市场扩张。西欧、亚太地区（不包括中国、印度和韩国）和拉丁美洲地区的折叠屏出货量实现了大幅增长，主要得益于中国手机品牌厂商，特别是荣耀和摩托罗拉的强劲表现。

4. 【TechInsights: 2025 年全球智能手机出货量将同比增长 2.9%】

《科创板日报》5 日讯，TechInsights 上调了 2024 年和 2025 年全球智能手机出货量的预测，预计 2024 年和 2025 年全球智能手机出货量将分别同比增长 4.5% 和 2.9%，推动整个手机市场销量同比增长 3.7% 和 0.7%。三星可以在 2024 年继续领先市场，但将在 2025 年首次被苹果超越。

5. 【机构：7 月全球半导体销售额达 513 亿美元 同比增长 18.7%】

《科创板日报》4 日讯，美国半导体行业协会（SIA）宣布，2024 年 7 月全球半导体行业销售额达到 513 亿美元，同比增长 18.7%，环比增长 2.7%。

6. 【日月光 8 月营收呈双增长 创九个月新高】

《科创板日报》10 日讯，半导体封测大厂日月光公布 8 月合并营收为 529.3 亿新台币，环比增长 2.6%、同比增长 1.2%，创下单月合并营收近九个月来新高。

7. 财联社 9 月 10 日电，联发科 8 月销售额 415.3 亿元台币，同比下降 1.72%。**8. 【华为发布全球首款三折叠屏手机 售价 19999 元起】**

财联社 9 月 10 日电，华为首款三折叠屏手机——华为 Mate XT 非凡大师 9 月 10 日正式发布，展开最大 10.2 英寸，展开最薄 3.6mm。价格方面，256GB 版本售价 19999 元、512GB 版本售价 21999 元、1TB 版本售价 23999 元，9 月 20 日 10:08 正式开售。

9. 【Canalys: 到 2028 年全球 54% 的智能手机出货为 AI 手机】

《科创板日报》10 日讯，Canalys 报告显示，2024 年全球 16% 的智能手机出货为 AI 手机，到 2028 年，这一比例将激增至 54%。受消费者对 AI 助手和端侧处理等增强功能需求的推动，2023 年至 2028 年间，AI 手机市场以 63% 的年均复合增长率 (CAGR) 增长。预计这一转变将先出现在高端机型上，然后逐渐为中端智能手机所采用，反映出端侧生成式 AI 作为更普适性的先进技术渗透整体手机市场的趋势。

10. 【全球智能手机销量 2024 年第二季度同比增长 6% 创自 2021 年第二季度以来最高同比增速】

财联社 9 月 11 日电，Counterpoint11 日发布《2024 年 Q2 各地区市场智能手机数据报告》。报告指出，2024 年第二季度，全球智能手机销量连续第三个季度同比增长，继续从过去十年来最低的一年中恢复。智能手机销量在 2024 年第二季度同比增长 6%，这是自 2021 年第二季度以来最高的同比增长率。几乎所有地区都实现了同比增长。前五大品牌与之前几个季度保持一致。三星保持第一位，苹果同比略有下降，而小米在前五大原始设备制造商中增长最快。vivo 在全球最大两个智能手机市场——中国和印度——排名第一。OPPO 紧随其后，位列前五。前五大品牌的累计份额略有下降，因为它们面临着来自紧追不舍的后五名品牌压力，主要是华为、HONOR、摩托罗拉和 TECNO。其中，不断扩展品牌影响力的摩托罗拉，达到了十年来最高的市场份额。

11. 【英伟达 CEO: Blackwell 需求太旺 供不应求让客户关系变得紧张】

财联社 9 月 12 日电，英伟达首席执行官黄仁勋表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他在旧金山举行的高盛技术会议上对听众说，“需求太旺了，每个人都希望自己能第一批拿到，大家都想订最多，我们的客户比较激动，这是理所应当的，的确很紧张，我们在尽力做到最好。”黄仁勋告诉听众，客户对最新一代 Blackwell 芯片的需求强劲。英伟达将硬件的实体生产外包了出去，供应商正在努力赶进度。

3. 公司公告与动态

1. 【龙芯中科：首款独立显卡芯片 9A1000 研制工作全面展开】

财联社 9 月 10 日电，龙芯中科在互动平台表示，公司研制的第二代通用图形处理器核支持图形渲染与通用计算，具备人工智能推理能力，其第一版设计已随 2K3000 交付流片。龙芯首款独立显卡芯片 9A1000 研制工作全面展开。其通用图形处理器核在 2K3000 的基础上进行了功能、性能扩展。龙芯 9A1000 的图形处理能力、通用算力以及 AI 算力将达到 2K3000 的四倍以上，同时保持芯片成本相当，将与龙芯 CPU 配套，形成高性价比产品。

4. 半导体产业数据更新

4.1 智能手机出货数据

全球智能手机出货数据：根据 IDC 数据，2024 年第二季度全球智能手机出货量为 2.85 亿台，同比增长 7.58%，环比下降 1.38%；2024 年上半年全球智能手机出货量为 5.75 亿台，同比增长 7.66%。

国内智能手机出货数据：根据工信部数据，2024 年 7 月国内智能手机出货量为 2,217.40 万台，同比增长 28.30%，环比下降 6.99%。2024 年 1-7 月国内智能手机累计出货量为 1.61 亿台，同比增长 13.66%。

图 2：全球智能手机季度出货量



图 3：国内智能手机月度出货情况



资料来源: IDC, 东莞证券研究所

资料来源: 工信部, 东莞证券研究所

4.2 新能源汽车销售数据

新能源汽车销售数据: 据工信部, 2024年8月, 国内新能源汽车总销量为110.0万辆, 同比增长30.0%, 环比下增长11.00%, 2024年8月国内汽车总销量为245.30万台, 其中新能源汽车销量占比为44.84%。

图 4: 新能源汽车销量及同比增长率



图 5: 国内新能源汽车销量及渗透率



资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

资料来源: 中汽协, 东莞证券研究所

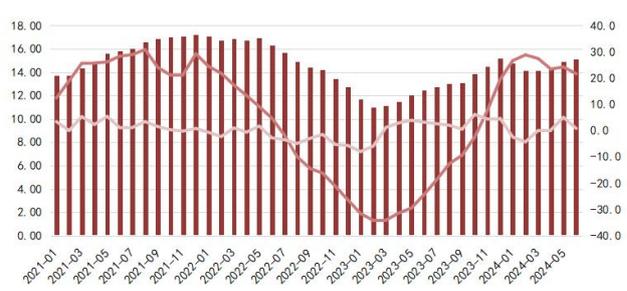
4.3 全球、国内半导体月度销售数据

全球、中国半导体销售数据: 根据美国半导体行业协会数据, 2024年7月全球半导体销售额513.2亿美元, 同比增长18.7%, 环比增长2.7%; 国内半导体2024年7月销售额为152.3亿美元, 同比增长19.5%, 环比增长0.9%。

图 6: 全球半导体月度销售情况



图 7: 中国半导体月度销售情况



资料来源: 美国半导体产业协会, 东莞证券研究所

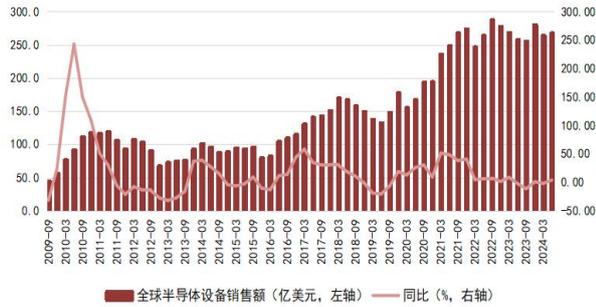
资料来源: 美国半导体产业协会, 东莞证券研究所

4.4 全球、中国大陆半导体设备销售数据

全国、中国大陆半导体设备销售额: 根据SEAJ数据, 2024年第二季度全球半导体设备销售额为267.8亿美元, 同比增长4.00%, 其中中国大陆半导体设备销售额为122.1亿美元, 同比增长62.00%。

图 8: 全球半导体设备销售额（季度）

图 9: 中国大陆半导体设备销售额（季度）



资料来源: SEAJ, 东莞证券研究所



资料来源: SEAJ, 东莞证券研究所

5. 投资建议

进入 2024 年, 伴随着下游需求回暖以及厂商推进库存去化, 半导体行业迈入上行周期, 从半年报业绩看, 半导体行业 2024 年上半年经营业绩实现同比增长, 设备、材料、存储、CIS、封测等细分板块龙头企业 Q2 业绩大多表现出色, 且苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期, 表明行业景气度延续, 而苹果、华为等消费电子大厂先后发布新机, 科技板块关注度有望提升。展望 Q4, 随着消费电子旺季的到来和内资晶圆厂产能扩充持续推进, 半导体行业景气度有望维持较好水平。可关注 Q2 业绩表现出色的设备、存储、CIS、封测等细分板块。

建议关注标的:

- **半导体设备与材料:** 北方华创 (002371)、华海清科 (688120)、拓荆科技 (688072)、长川科技 (300604)、鼎龙股份 (300054)、江丰电子 (300666);
- **存储芯片:** 兆易创新 (603986)、澜起科技 (688008)、佰维存储 (688525);
- **模拟芯片:** 圣邦股份 (300661);
- **先进封装:** 长电科技 (600584)、通富微电 (002156);
- **CIS:** 韦尔股份 (603501)、思特威 (688213);
- **算力芯片:** 海光信息 (688041)
- **晶圆代工:** 中芯国际 (688981)

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/9/13)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
002371	北方华创	据公司半年报, 公司 2024 年上半年实现营收 123.35 亿元, 同比增长 46.38%, 实现归母净利润 27.81 亿元, 同比增长 54.54%, 对应 24Q2 营收为 64.76 亿元, 同比增长 42.15%, 环比增长 10.52%, 对应

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/9/13)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		24Q2 归母净利润为 16.54 亿元, 同比增长 36.98%, 环比增长 46.82%。报告期内, 公司持续精研客户需求, 丰富产品矩阵, 不断提升核心竞争力。公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升, 收入同比稳健增长; 此外, 随着公司营收规模持续扩大, 规模效应逐渐显现; 智能制造助力运营水平有效提升; 成本费用率稳定下降, 使得归属于上市公司股东的净利润同比持续增长。
688120	华海清科	公司 2024 年上半年实现营收 14.97 亿元, 同比增长 21.23%, 实现归母净利润 4.33 亿元, 同比增长 15.65%, 对应 24Q2 营收为 8.16 亿元, 同比增长 32.03%, 环比增长 20.00%, 对应 24Q2 归母净利润为 2.31 亿元, 同比增长 27.89%, 环比增长 14.03%。报告期内, 全球半导体行业呈现回暖趋势, 叠加 AI、高性能计算等领域快速发展, 对芯片性能和功耗要求不断提高, 通过内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装的 Chiplet 和基于 2.5D/3D 封装技术将 DRAMDie 垂直堆叠的高带宽存储器 (HBM) 等先进封装技术和工艺成为未来发展的重要方向。公司产品研发始终坚持以市场和客户需求为导向, 持续深耕半导体关键装备与技术服务, 一方面基于现有产品不断进行更新迭代, 另一方面积极布局新技术新产品的开发拓展, 在 CMP 装备、减薄装备及其他产品方面取得了积极成果, 因此 24Q2 营收、归母净利润实现同比、环比大幅增长。
688072	拓荆科技	公司 2024 年上半年实现营收 12.67 亿元, 同比增长 26.22%, 实现归母净利润 1.29 亿元, 同比增长 3.64%, 对应 24Q2 营收为 7.95 亿元, 同比增长 32.22%, 环比增长 68.53%, 对应 24Q2 归母净利润为 1.19 亿元, 同比增长 67.43%, 环比增长 1032.79%。报告期内, 公司继续聚焦薄膜沉积行业和混合键合设备行业, PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、超高深宽比沟槽填充 CVD 等薄膜设备产品系列及混合键合设备产品系列均已在客户端实现产业化应用, 量产规模逐步扩大, 其设备性能和产能均达到国际领先水平。
300604	长川科技	公司 2024 年上半年实现营收 15.28 亿元, 同比增长 100.46%, 实现归母净利润 2.15 亿元, 同比增长 949.29%, 对应 24Q2 营收为 9.69 亿元, 同比增长 119.03%, 环比增长 73.18%, 对应 24Q2 归母净利润为 2.11 亿元, 同比增长 171.27%, 环比增长 5,072.91%。公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备, 目前公司主要销售产品为测试机、分选机、自动化设备及 AOI 光学检测设备等。公司生产的测试机包括大功率测试机、模拟测试机、数字测试机等; 分选机包括重力式分选机、平移式分选机、测编一体机; 自动化设备包括指纹模组、摄像头模组等领域的自动化生产设备; AOI 光学检测设备包括晶圆光学外观检测设备、电路封装光学外观检测设备。报告期内, 国内集成电路行业总体温和复苏, 细分领域客户需求提升显著, 公司研发项目不断加大投入, 产品线不断丰富, 大客户战略得到深化, 小客户不断开发等多方面积极作用, 公司应用于集成电路测试领域的产品覆盖度不断拓宽, 市场占有率持续稳步攀升, 营业收入、归母净利润较上年同期有较大幅度的增长。
300054	鼎龙股份	公司 2024 年上半年实现营收 15.19 亿元, 同比增长 31.01%, 实现归母净利润 2.18 亿元, 同比增长 127.22%, 对应 24Q2 营收为 8.11 亿元, 同比增长 32.35%, 环比增长 14.52%, 对应 24Q2 归母净利润为 1.36 亿元, 同比增长 122.88%, 环比增长 67.04%。报告期内, 公司聚焦于半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块, 并在传统打印复印通用耗材业务领域进行了全产业链布局, 受益于下游晶圆厂和面板厂的稼动率回升, 以及新产品 PI、抛光液等快速放量, 公司 24Q2 经营业绩实现同比增长, 且利润率水平持续提升。
300666	江丰电子	公司 2024 年上半年实现营收 16.27 亿元, 同比增长 35.91%, 实现归母净利润 1.61 亿元, 同比增长 5.32%, 对应 24Q2 营收为 8.55 亿元, 同比增长 35.25%, 环比增长 10.70%, 对应 24Q2 归母净利润为 1.01 亿元, 同比增长 4.27%, 环比增长 70.15%。报告期内公司超高纯靶材和精密零部件业务均实现快速增长, 营收创历史新高, 且得益于公司在先进制程产品竞争力的强化和全球市场份额的扩大, 以及在精密零部件领域的战略布局和生产基地的建设, 公司盈利能力实现提升。

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/9/13)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
603986	兆易创新	公司 2024 年上半年实现营收 36.09 亿元, 同比增长 21.69%, 实现归母净利润 5.17 亿元, 同比增长 53.88%; 对应 2024 年二季度实现营收 19.82 亿元, 同比+21.99%, 环比+21.78%, 对应 24Q2 实现归母净利润 3.12 亿元, 同比+67.95%, 环比+52.46%。公司坚持多赛道多产品线的组合布局, 现有产品主要分为存储器产品、微控制器产品以及传感器产品。报告期内, 在 AI 服务器等需求拉动下, 全球半导体行业呈复苏态势。公司各项业务恢复顺利, 营收、归母净利润实现同比、环比增长, 且盈利能力有所提升。
688008	澜起科技	公司 2024 年上半年实现营收 16.65 亿元, 同比增长 79.49%, 实现归母净利润 5.93 亿元, 同比增长 624.63%, 对应 24Q2 营收为 9.28 亿元, 同比增长 82.59%, 环比增长 25.83%, 对应 24Q2 归母净利润为 3.70 亿元, 同比增长 495.07%, 环比增长 65.50%。盈利能力方面, 公司 2024 年上半年销售毛利率为 57.78%, 相比上年同期提高 1.45 个百分点, 2024 年上半年销售净利率为 35.63%, 相比上年同期提高 26.79 个百分点; 分季度来看, 公司 24Q2 销售毛利率为 57.83%, 同比-1.00pct, 环比+0.13pct, 公司 24Q2 销售净利率为 39.86%, 同比+27.61pct, 环比+9.55pct。报告期内, 全球集成电路行业景气度回暖, 而受益于 AI 的强劲需求, 全球服务器行业保持较高景气度, 在经历 2023 年的行业整体去库存后, 2024 年开始恢复性增长。根据 2024 年 7 月 Gartner 发布的《2024 年第一季度全球服务器市场报告》显示, 2024 年第一季度全球服务器市场销售额保持增长, 销售额 407.5 亿美元, 同比增长 59.9%; 出货量 282.0 万台, 同比增长 5.9%。公司的产品内存接口及模组配套芯片、PCIe Retimer 芯片、MXC 芯片、津逮®CPU 以及混合安全内存模组等主要应用于服务器, 因此受益于服务器行业景气回暖, 2024 年上半年及 2024 年第二季度景气度实现同比大幅增长, 盈利能力有所提升。
688525	佰维存储	公司 2024 年上半年实现营收 34.41 亿元, 同比增长 199.64%, 实现归母净利润 2.83 亿元, 同比增长 195.58%, 对应 24Q2 营收为 17.14 亿元, 同比增长 137.15%, 环比下降 0.72%, 对应 24Q2 归母净利润为 1.16 亿元, 同比增长 167.93%, 环比下降 30.89%。受益存储器行业复苏, 报告期内公司业务收入得到显著提升, 其中 24H1 存储产品业务收入达到 32.66 亿元, 远超上年同期的 10.61 亿元, 先进封装与测试业务也有所增长, 从 2023H1 的 0.41 亿元提升至 0.66 亿元。
300661	圣邦股份	公司 2024 年上半年实现营收 15.76 亿元, 同比增长 37.27%, 实现归母净利润 1.79 亿元, 同比增长 99.31%, 对应 24Q2 营收为 8.47 亿元, 同比增长 33.42%, 环比增长 16.23%, 对应 24Q2 归母净利润为 1.24 亿元, 同比增长 109.10%, 环比增长 128.50%。公司产品覆盖信号链和电源管理两大领域, 不断加深与客户合作, 持续加大在工业和汽车电子等领域的投入, 积极开拓新市场、新客户, 进一步完善供应链管理与成本控制, 保持公司的持续稳健发展。
603501	韦尔股份	公司 2024 年上半年实现营收 120.91 亿元, 同比增长 36.50%, 实现归母净利润 13.67 亿元, 同比增长 792.79%, 对应 24Q2 营收为 64.48 亿元, 同比增长 42.55%, 环比增长 14.24%, 对应 24Q2 归母净利润为 8.09 亿元, 同比增长 1869.21%, 环比增长 45.08%。报告期内, 受益于下游需求回暖和产品结构优化, 公司 24Q2 营收、归母净利润实现同比、环比提升。手机传感器方面, 公司推出了 1.2um5000 万像素的高端图像传感器 OV50H, 以及全球首款采用 TheiaCe 技术的智能手机图像传感器 OV50K40, 标志着公司在高端产品市场取得重大突破; 汽车传感器方面, 公司图像传感器业务在汽车市场的收入同比增长 53.06%, 推出的 OX08D10 和 OX05D10 图像传感器, 均采用了 TheiaCe 技术, 具有业界领先的性能, 已成功应用于多个汽车平台, 未来有望实现稳健成长。
688213	思特威	公司 2024 年上半年实现营收 24.57 亿元, 同比增长 129.04%, 实现归母净利润 1.50 亿元, 同比增长 325.81%, 对应 24Q2 营收为 16.19 亿元, 同比增长 161.90%, 环比增长 94.40%, 对应 24Q2 归母净利润为 1.36 亿元, 同比增长 433.94%, 环比增长 868.02%。报告期内, 公司智能手机业务实现营收 12.49 亿元, 同比增长 295%, 成为驱动公司业绩成长的主要动力, 其中高阶 CIS 产品占智能手机业务比重超过 50%, 显著推动公司业绩提升。
600584	长电科技	进入 2024 年以来, 随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应

表 3: 建议关注标的介绍 (2024/9/13)

股票代码	股票名称	建议关注标介绍
		用领域带动等因素作用, 2024 年全球半导体市场重回增长轨道。根据 WSTS 数据统计, 2024 年上半年全球半导体销售额为 2,908 亿美元, 同比增长 18.1%, 其中中国半导体销售额为 872.3 亿美元, 同比增长 25.28%, 增速快于全球平均水平。受益下游需求回暖, 公司经营业绩实现同比、环比增长。营收方面, 公司 24Q2 实现营收 86.45 亿元, 同比+36.94%, 环比+26.34%, 单季度营收创历史同期新高; 净利润方面, 公司 24Q2 实现归母净利润 4.84 亿元, 同比+25.51%, 环比+2.50%, 净利润增速小于营收增速, 主要为 24H1 非经常性损益减少 (公司 24H1 政府补助等非经常性损益较上年同期减少 0.39 亿元), 影响了公司利润端表现。盈利能力方面, 公司 24Q2 销售毛利率为 14.28%, 同比下降 0.83pct, 环比提升 2.08pct, 24Q2 销售净利率为 5.59%, 同比下降 0.52pct, 环比提升 3.64pct。报告期内, 公司旗下工厂稼动率持续提升, 带来销售毛利率、净利率实现环比改善。
002156	通富微电	据公司半年报, 公司 2024 年上半年实现营收 110.80 亿元, 同比增长 11.83%, 实现归母净利润 3.23 亿元, 同比增长 271.91%, 对应 24Q2 营收为 57.98 亿元, 同比增长 10.10%, 环比增长 9.77%, 对应 24Q2 归母净利润为 2.24 亿元, 同比增长 216.61%, 环比增长 127.60%。盈利能力方面, 公司 2024 年上半年销售毛利率为 14.16%, 相比上年同期提高 3.74 个百分点, 2024 年上半年销售净利率为 3.30%, 相比上年同期提高 5.36 个百分点; 分季度来看, 公司 24Q2 销售毛利率为 16.00%, 同比+4.73 pct, 环比+3.86pct, 公司 24Q2 销售净利率为 4.31%, 同比+8.39pct, 环比+2.11pct。进入 2024 年以来, 随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用, 2024 年全球半导体市场重回增长轨道。根据 WSTS 数据统计, 2024 年上半年全球半导体销售额为 2,908 亿美元, 同比增长 18.1%, 其中中国半导体销售额为 872.3 亿美元, 同比增长 25.28%, 增速快于全球平均水平。受益高性能计算、AI 手机、AI PC 等因素驱动, 公司 24Q2 经营业绩实现同比、环比高速增长, 且盈利能力有所提升。
688041	海光信息	公司于 8 月 15 日披露半年报。公司 2024 年上半年实现营收 37.63 亿元, 同比增长 44.08%, 实现归母净利润 8.53 亿元, 同比增长 25.97%。报告期内, 营业收入同比实现较快增长, 主要系市场需求增加, 客户对公司产品的认可度进一步提升; 同时公司持续提升产品性能, 加大市场拓展力度, 加强与客户及生态伙伴的合作深度与广度, 促进了主营业务的较快增长。此外, 公司持续加大研发投入力度, 产品竞争力不断增强, 研发投入同比增长 11.54%, 营业收入增幅更大, 使研发投入占营业收入比例有小幅下降。
688981	中芯国际	据公司半年报, 公司 2024 年上半年实现营收 262.69 亿元, 同比增长 23.23%, 实现归母净利润 16.46 亿元, 同比下降 45.07%, 对应 24Q2 营收为 136.76 亿元, 同比增长 23.10%, 环比增长 8.59%, 对应 24Q2 归母净利润为 11.37 亿元, 同比下降 19.11%, 环比增长 123.46%。盈利能力方面, 公司 2024 年上半年销售毛利率为 13.91%, 相比上年同期下降 8.53 个百分点, 2024 年上半年销售净利率为 6.25%, 相比上年同期下降 11.00 个百分点; 分季度来看, 公司 24Q2 销售毛利率为 13.65%, 同比-8.49 pct, 环比-0.54pct, 公司 24Q2 销售净利率为 8.71%, 同比-7.83pct, 环比+5.14pct。2024 年上半年, 全球半导体产业整体呈现复苏迹象, 产业链回暖趋势基本确立, 晶圆代工作为产业链前端的关键行业迎来一定的需求反弹, 带动公司 24H1 营收实现同比增长, 24Q2 营收实现同比、环比增长。盈利能力方面, 报告期内公司 12 英寸产能建设加速, 逆势扩产导致折旧费用同比增加, 叠加报告期内晶圆代工价格降低影响了企业的盈利能力, 导致公司盈利能力承压。 据公司此前港股发布的 24Q2 未经审核业绩公告, 公司对 24Q3 收入指引为环比增长 13%至 15%, 毛利率介于 18%到 20%范围内, 指引较为积极。进入 24Q3, 受地缘政治影响, 本土化需求加速提升, 主要市场领域的芯片套片产能供不应求, 公司 12 英寸产能紧俏, 价格向好。产品结构方面, 公司今年扩产都在 12 英寸, 附加值相对较高, 新扩充产能得到充分利用并带来收入, 促进产品组合优化调整, 因此公司对 24Q3 展望乐观。

资料来源: iFind, 东莞证券研究所

6. 风险提示

(1) **终端需求不及预期：**从 24Q1 业绩看，半导体行业已进入上行周期，从 24Q2 业绩看产业趋势已经明确，以智能手机为代表的终端需求回暖对板块业绩构成支撑。若后续下游需求不及预期，则可能对相关上市公司业绩造成不利影响；

(2) **国产替代不及预期：**半导体设备与材料、高端元器件等领域的国产替代是大势所趋，若产业链公司技术突破不如预期导致国产替代进程受阻，则可能面临业绩增速放缓的风险；

(3) **价格竞争加剧：**目前在集成电路、被动元器件等领域，国内上市企业以生产中低端产品为主，高端领域国产替代空间较大。若上市企业进行大量产能扩张，则行业未来可能面临产能过剩的局面，带来价格竞争导致盈利能力下滑的风险。

东莞证券研究报告评级体系:

公司投资评级	
买入	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 15%以上
增持	预计未来 6 个月内, 股价表现强于市场指数 5%-15%之间
持有	预计未来 6 个月内, 股价表现介于市场指数±5%之间
减持	预计未来 6 个月内, 股价表现弱于市场指数 5%以上
无评级	因无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 导致无法给出明确的投资评级; 股票不在常规研究覆盖范围之内

行业投资评级	
超配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现强于市场指数 10%以上
标配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现介于市场指数±10%之间
低配	预计未来 6 个月内, 行业指数表现弱于市场指数 10%以上

说明: 本评级体系的“市场指数”, A股参照标的为沪深 300 指数; 新三板参照标的为三板成指。

证券研究报告风险等级及适当性匹配关系	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	主板股票及基金、可转债等方面的研究报告, 市场策略研究报告
中高风险	创业板、科创板、北京证券交易所、新三板(含退市整理期)等板块的股票、基金、可转债等方面的研究报告, 港股股票、基金研究报告以及非上市公司的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

投资者与证券研究报告的适当性匹配关系: “保守型”投资者仅适合使用“低风险”级别的研报, “谨慎型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中低风险”的研报, “稳健型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中风险”的研报, “积极型”投资者仅适合使用风险级别不高于“中高风险”的研报, “激进型”投资者适合使用我司各类风险级别的研报。

证券分析师承诺:

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力, 以勤勉的职业态度, 独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点, 不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系, 没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益, 或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

声明:

东莞证券股份有限公司为全国性综合类证券公司, 具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告, 亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下, 本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用, 并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险, 据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有, 未经本公司事先书面许可, 任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发, 需注明本报告的机构来源、作者和发布日期, 并提示使用本报告的风险, 不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的, 应当承担相应的法律责任。

东莞证券股份有限公司研究所

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码: 523000

电话: (0769) 22115843

网址: www.dgzq.com.cn